证券代码：002983　　证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-009

投资者关系活动类别	☑ 特定对象调研　　□分析师会议 □ 媒体采访　　□业绩说明会 □新闻发布会　　□路演活动 □现场参观 ☑ 其他（ 线上调研 ）
参与单位名称及人员姓名	长城证券 邹兰兰 富国基金 黄天擎
时间	2026年11月3日
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：唐先胜
投资者关系活动主要内容介绍	问题1、微显示全彩化技术进展 回答： 公司依托在Mini/Micro-LED领域的长期研发与工程化沉淀，协同中国科学技术大学、合肥工业大学等高校科研力量，持续推进面向AR-AI显示的MicroLED微显示全彩化技术与核心光机攻关。 公司AI+AR眼镜显示路线聚焦“MicroLED微显示像源+全彩化关键方案+光引擎/光机组件+系统集成”的协同突破，重点开展高亮度、低功耗MicroLED微显示像源、全彩化与高色域显示方案及光引擎/光机组件等关键技术研发。 报告期内，公司在全彩化技术方面取得阶段性进展，已基本完成数十微米级量子点光刻胶（QD-PR）图形化及色转换工艺验证，并进一

	步向微米级高精度图形化及色转换工艺迭代。同时，公司结合高校科研及专业中试平台资源，持续推进微米级MicroLED器件结构设计、晶圆工艺开发与验证，相关研发工作有序开展。 在应用拓展方面，公司积极推进MicroLED智能像素车灯研发，已完成约1.8万像素版本样机。约4万像素版本样机正在积极推进性能提升与可靠性验证，持续提升MicroLED封装、驱动、光学及系统集成等关键技术能力。 公司AI+AR眼镜专项研发团队覆盖微显示器件与工艺、硬件驱动、电路与算法、光学与材料表征、系统集成等关键环节，核心研发骨干由多名博士及资深工程师组成，具备新型显示、AR近眼光学、硬件驱动与材料表征等复合背景，为相关技术的持续迭代及样机集成提供研发支撑。 问题2、客户交流或导入情况 回答： 公司与潜在客户有技术上的交流，尚未达到客户导入或产品送样阶段。 问题3、项目整体规划进度，比如中试或量产的时间计划 回答： 公司微显示全彩化技术项目按计划推进，目前仍在研究阶段。详细规划涉及信息披露的，公司将严格履行。 问题4、公司微显示有光波导技术研发与生产吗 回答： 公司微显示光机模组会应用到光波导产品，公司目前未开展光波导技术研究与生产。 问题5、MiniCOB或RGB技术的产线与微显示产品生产线可以复用吗 回答： 像素车灯、Al+AR眼镜光机或模组等产品与现有MiniCOB、RGB等技术存在部分工艺共性，但产线配置及核心制造工艺存在较大差异。 以上信息未涉及内幕信息。 本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。

附件清单（如有）	无
日期	2026年11月3日